

決算説明会

2014年 3月期
上半期決算

2013年 11月6日

業績報告・経営施策

LSI戦略

ディスクリート・モジュール戦略

(単位:百万円)

	上半期 実績	期初計画比	前年同期比
売上高	167,979	+16,979	+17,226
	期初予想 : 151,000	(+11.2%)	(+11.4%)
営業利益	10,338	+938	+7,696
	期初予想 : 9,400	(+10.0%)	(+291.3%)
経常利益	16,743	+9,643	+16,392
	期初予想 : 7,100	(+135.8%)	(48倍)
当期純利益	12,244	+5,744	+12,415
	期初予想 : 6,500	(+88.4%)	(黒字転換)
EBITDA	21,808	▲792	+1,456
	期初予想 : 22,600	(▲3.5%)	(+7.2%)

'14/3期 上半期

（単位：百万円）

	日 本	海 外			合 計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	+14.3%	+10.6%	+7.1%	+64.4%	+31.1%	+11.8%
	+3,166	+5,186	+3,156	+1,538	+492	+8,351
半導体素子	+7.8%	+21.8%	+19.7%	+49.3%	+21.8%	+17.5%
	+1,209	+7,569	+5,912	+1,171	+485	+8,778
モジュール	+5.0%	+9.1%	+8.0%	+2.5%	+25.9%	+8.1%
	+188	+1,043	+799	+13	+232	+1,231
そ の 他	▲24.6%	+3.8%	▲0.3%	+35.1%	+17.1%	▲9.3%
	-1,683	+302	-19	+193	+128	-1,382
合 計	+6.0%	+13.7%	+10.8%	+49.8%	+24.5%	+11.2%
	+2,879	+14,101	+9,848	+2,915	+1,338	+16,979

'14/3期 上半期

（単位：百万円）

	日 本	海 外			合 計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	▲9.7%	+19.0%	+17.8%	+13.5%	+80.1%	+8.1%
	-2,704	+8,616	+7,226	+466	+923	+5,912
半導体素子	▲5.6%	+27.4%	+23.0%	+82.2%	+38.0%	+15.9%
	-984	+9,081	+6,734	+1,601	+746	+8,098
モジュール	+1.0%	+18.1%	+18.0%	▲4.0%	+33.7%	+13.4%
	+39	+1,911	+1,651	-23	+284	+1,950
そ の 他	▲12.3%	+31.9%	+30.0%	+47.6%	+34.0%	+10.4%
	-727	+1,994	+1,532	+240	+221	+1,266
合 計	▲7.9%	+22.7%	+20.4%	+35.2%	+47.2%	+11.4%
	-4,375	+21,601	+17,143	+2,283	+2,175	+17,226

(単位:百万円)

	通期予想	期初計画比	前年同期比
売上高	320,000	20,000	27,590
	期初予想 : 300,000	(+6.7%)	(+9.4%)
営業利益	19,000	2,500	19,921
	期初予想 : 16,500	(+15.2%)	(黒字転換)
当期純利益	17,000	3,500	69,464
	期初予想 : 13,500	(+25.9%)	(黒字転換)
EBITDA	44,800	-1,000	6,842
	期初予想 : 45,800	(▲2.2%)	(+18.0%)

'14/3期 通期計画

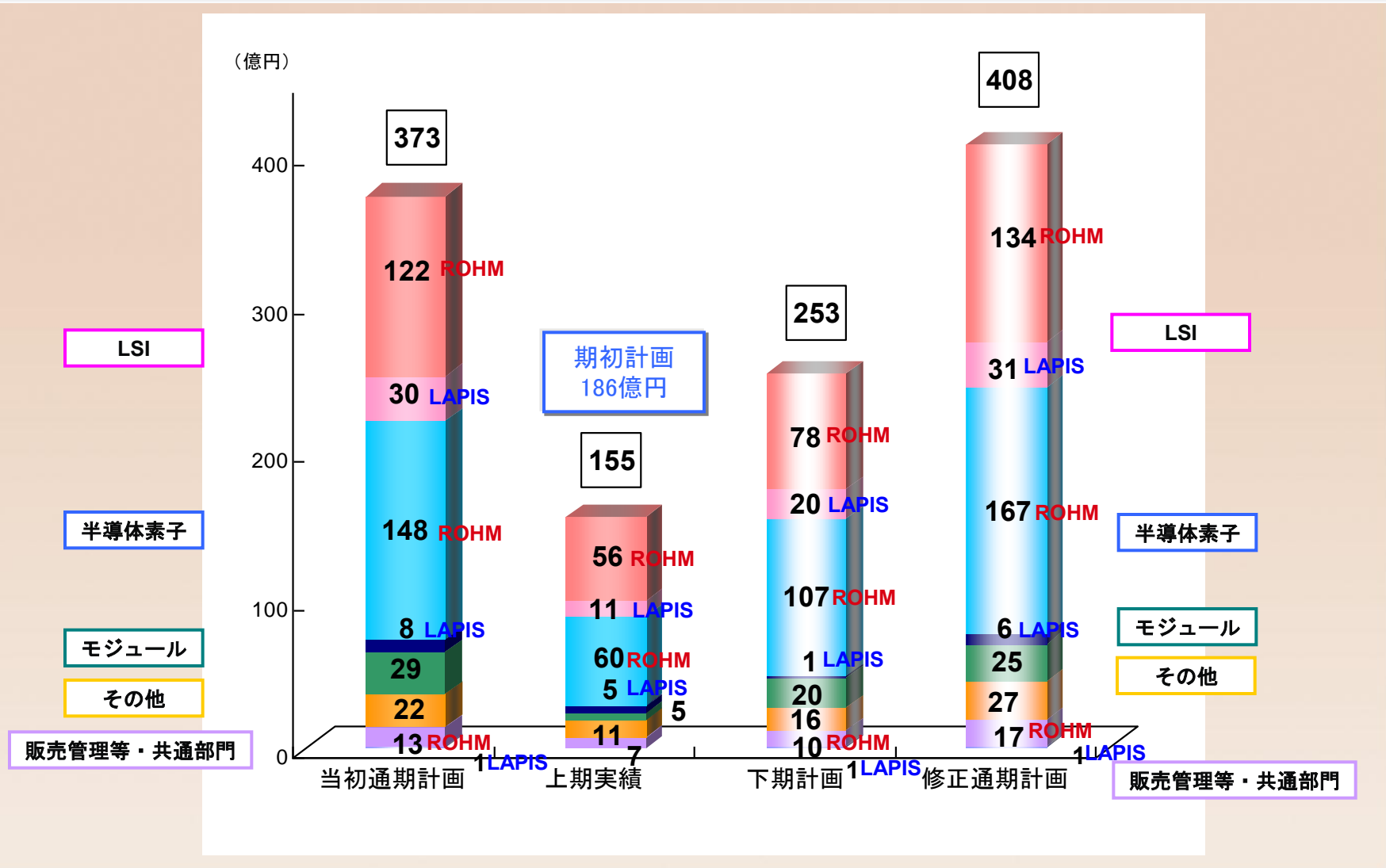
（単位：百万円）

	日 本	海 外			合 計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	+19.2%	+1.8%	▲0.1%	+22.3%	+22.5%	+6.7%
	+7,638	+1,771	-132	+1,181	+722	+9,409
半導体素子	+10.4%	+13.9%	+13.0%	+27.6%	+11.3%	+12.8%
	+3,176	+9,556	+7,710	+1,320	+527	+12,732
モジュール	+2.1%	+1.1%	▲0.1%	+0.3%	+15.3%	+1.4%
	+165	+251	-29	+3	+276	+415
その他	▲16.1%	▲3.5%	▲7.2%	+17.5%	+17.2%	▲8.8%
	-1,983	-574	-1,018	+190	+253	-2,557
合 計	+9.9%	+5.3%	+3.5%	+22.0%	+16.0%	+6.7%
	+8,996	+11,004	+6,531	+2,694	+1,778	+20,000

'14/3期 通期計画

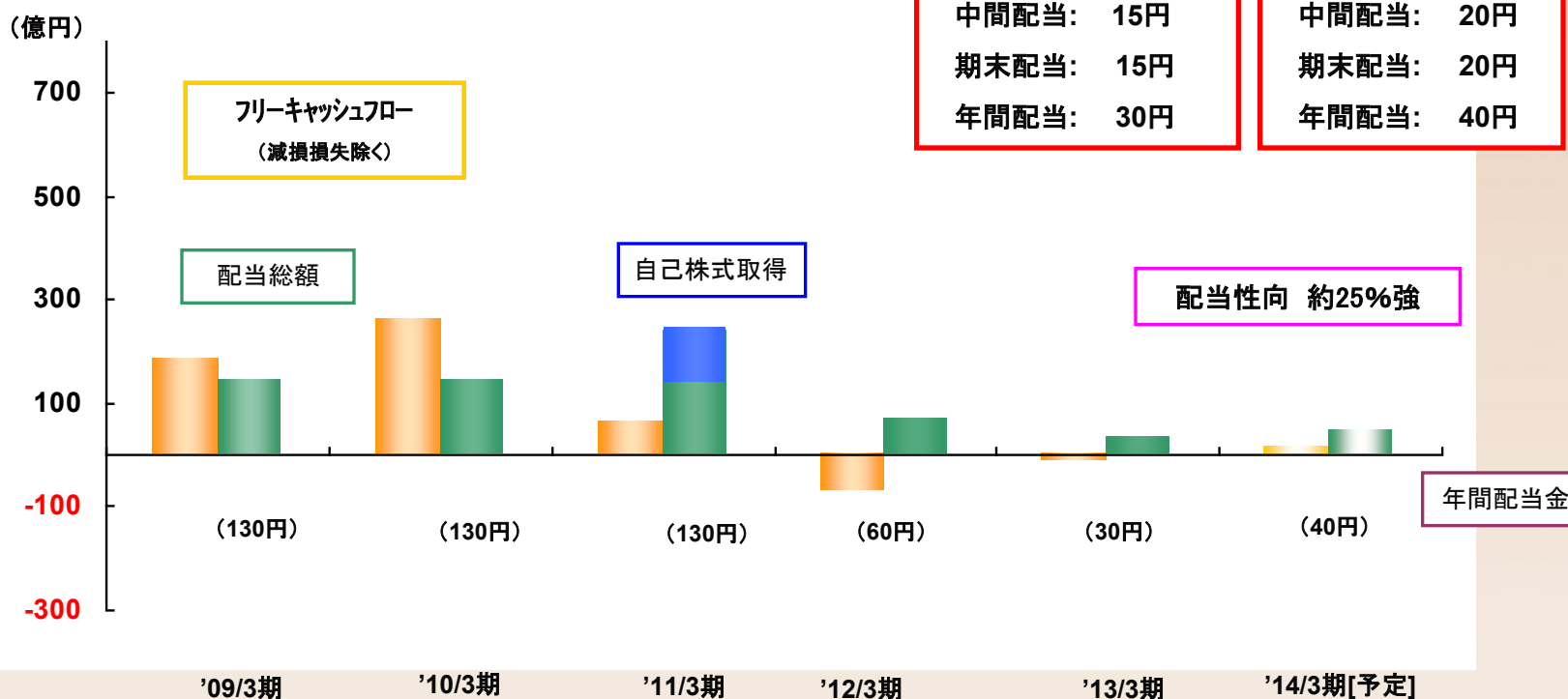
（単位：百万円）

	日 本	海 外			合 計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	▲ 8.1%	+15.3%	+15.3%	▲ 0.9%	+57.2%	+6.7%
	-4,162	+13,655	+12,282	-59	+1,432	+9,493
半導体素子	+0.6%	+19.3%	+17.0%	+46.3%	+23.3%	+13.0%
	+199	+12,687	+9,780	+1,927	+980	+12,886
モジュール	+8.7%	+10.8%	+11.3%	▲ 0.8%	+12.9%	+10.2%
	+649	+2,245	+2,015	-8	+237	+2,894
そ の 他	▲ 2.5%	+19.2%	+18.3%	+22.8%	+23.2%	+9.6%
	-261	+2,578	+2,016	+237	+325	+2,317
合 計	▲ 3.5%	+16.5%	+15.7%	+16.3%	+29.9%	+9.4%
	-3,575	+31,164	+26,093	+2,098	+2,973	+27,590



今期の株主還元

1. 設備投資とM&Aの拡大など、事業に対する投資を優先し、中長期的な業績向上に努めます。
2. 業績及びキャッシュフロー状況を勘案し、今期は10円増配します。



売上を拡大する

(ターゲット市場にロームの強みを確実に浸透させる)

1.市場改革

- ・自動車市場への注力
- ・産業機器市場の開拓
- ・海外顧客のウエイトを上げる。

2.強い分野にリソースを集中し、ライバルに勝つ。

- ・アナログパワーデバイスでLSIを復活させる。
- ・新技術・新工程によるブレイクスルーで、ディスクリート商品の売上を上げる。
- ・4つの成長商品群に注力し、売上を上げる。

ロームの強み

垂直統合体制

製造技術

最先端プロセス

BiCDMOS
130nm, 300mmウエハ

高耐圧プロセス

SOIによる誘電体分離/
トランスセル
600V、700V/2,500V

パッケージ技術

- ・豊富なコンシューマ用
小型パッケージ
- ・大電力大型パッケージ
- ・IPM等

ディスクリート

SiC/SJ-MOS/Presto-MOS/HybridMOS/IGBT
Power Tr/Power Di/Power R

回路技術

経験豊富な
アナログエンジニア

ロームエンジニアの
90%以上

幅広い
アナログ技術領域

- ・電源
- ・モータドライバ
- ・LEDドライバ
- ・オーディオ
- ・インターフェース
- ・
- ・

EMC技術

競争力のある 商品提案が可能

外付パワーディスクリートを含めた

- ・アナログ回路最適化
- ・複合化
- ・システムレベルでの最適化



それぞれの領域で
TOPクラスの最適提案

高品質

高性能

高信頼性

ロームの**強い技術**により、より**競争力のある事業展開**へ

1

パワー市場向け製品の開発、商品展開強化

- ・他社にない幅広い商品展開強化
- ・世界最先端パワーデバイス展開強化

2

革新的な工法による独自の超小型化、
高機能化デバイスRASMID[®]シリーズの展開

3

生産ライン刷新による小信号個別半導体 競争力強化



**2014年3月期上半期
決算説明会**